证券代码：688347　　证券简称：华虹宏力

华虹宏力半导体有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐特定对象调研　☐分析师会议　☐媒体采访 ☑业绩说明会　☐新闻发布会　☐路演活动 ☐现场参观　☐其他_____
参与对象	华泰证券、中信证券、国信证券、盛博、中信里昂、中银国际及其他通过电话或网络方式参与华虹宏力半导体 2026 年第三季度业绩说明会的广大机构与个人投资者。
时间	2026 年 11 月 5 日 17：00
地点	电话/网络会议 （https://www.huahonggrace.com/c/ir_calendar.php）
上市公司出席人员	白鹏　董事会主席、总裁兼执行董事 王鼎　执行副总裁兼首席财务官 钱蕾　董办部长
公司介绍	华虹宏力半导体有限公司（“华虹宏力”，A 股代码：688347，港股代码：01347）（“本公司”）是全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业，秉持“8 英寸 + 12 英寸”、先进“特色 IC + 功率器件”的发展战略，为客户提供多元化的晶圆代工及配套服务。本公司专注于嵌入式/独立式非易失性存储器、模拟与电源管理、逻辑与射频和功率器件等特色工艺技术的持续创新，有力支持人工智能及数据中心、新能源汽车、工业智造、绿色能源、物联网等新兴领域应用，其卓越的质量管理体系亦满足汽车电子芯片生产的严苛要求。本公司是中国先进芯片制造主流工艺技术拥有者华虹集团的一员。 本公司在上海金桥和张江拥有三座 8 英寸晶圆厂和一座 12 英寸晶圆厂。另在江苏省无锡高新技术产业开发区内建有两座全球领先的 12 英寸特色工艺晶圆厂。目前，本公司正在推进无锡三期 12 英寸生产线的建设。 如欲取得更多公司相关资料，请浏览：www.huahonggrace.com。
投资者关系活动主要	总裁致辞

内容	华虹宏力董事会主席兼总裁白鹏博士对公司二零二六年第三季度业绩评论道： “二零二六年第三季度，公司完成对华力微的收购，历时一年的努力圆满收官。据此，除另有说明外，公司所有财务报告现均包含华力微。 过去一个季度，华虹宏力实现销售收入 9.871 亿美元，按重述后可比口径同比增长 19.9%（剔除华力微后，销售收入为 8.034 亿美元，高于上季度指引 7.7 亿至 7.8 亿美元的区间上限）。毛利率为 24.6%，同比上升 7.6 个百分点（剔除华力微后，毛利率为 19.9%，高于上季度指引 16%至 18%的区间上限）。本季度母公司拥有人应占利润达 1.234 亿美元。销售收入大幅增长，再创历史新高，关键财务指标同比及环比均显著提升。本季度，公司晶圆厂保持高产能利用率，出货量与平均销售价格均稳步上行，并继续按计划推进产能扩张项目。华力微整合已证明能带来财务增益及运营协同。目前，十二英寸业务的收入占比已达 70.7%。” 白总继续表示：“人工智能相关产品持续拉动全球半导体市场需求。工业及汽车市场正逐步改善。作为拥有广泛技术组合的特色工艺晶圆代工企业，华虹宏力的微控制器、闪存、电源管理及功率器件等产品需求日益增长，即使公司持续扩充产能，部分细分领域的供应仍相应趋紧。我们预计量价齐升的态势将持续一段时间。公司将继续全力聚焦卓越运营，为股东创造价值。” 财务摘要 二零二六年第三季度主要财务指标（未经审核） ● 销售收入达 9.871 亿美元，同比增长 19.9%，环比增长 9.9%。不含华力微合并的销售收入 8.034 亿美元，超过季度指引 7.7 亿美元至 7.8 亿美元之间。 ● 毛利率 24.6%，同比上升 7.6 个百分点，环比上升 4.7 个百分点。不含华力微合并的毛利率 19.9%，超过季度指引 16%至 18%之间。 ● 母公司拥有人应占利润 1.234 亿美元，同比上升 147.1%，环比上升 77.7%。 二零二六年第四季度指引

	● 我们预计销售收入约在 10.8 亿美元至 10.9 亿美元之间。 ● 我们预计毛利率约在 25%至 26%之间。 问答环节 1. 公司第三季度业绩在应用领域和价格方面的具体驱动因素是什么？另外，展望第四季度指引，其中多少来自华力微并表，多少来自 ASP 与出货量的持续增长？ 答：关于本季度，从技术平台看，涨价幅度相对较大的包括 MCU、闪存和部分电源管理产品（PMIC），部分功率器件也有选择性提价。逻辑平台以 CIS 为主，提价并不显著，仅有小幅调整。产品占比按顺序排列大致为 MCU、闪存、PMIC、CIS/RF 相关产品（目前体量较小），其后为功率器件。总体上多个平台均有价格调整，但公司会根据不同平台、具体产品及供需情况差异化实施，并非所有产品采用统一幅度。 第四季度收入指引主要基于我们预计的出货量和平均销售价格。出货量方面，增量主要来自无锡二期（ FAB 9A） 新增的 12 英寸产能。华力微方面，我们预计其产能不会有明显增加，第三季度的产出水平与第四季度大致相当。因此，从出货量角度看，收入增量并非来自华力微。 另一个因素是平均销售价格。如各位所知，我们今年以来陆续采取了价格措施，各项措施的实施时点不同，其中较晚实施的部分将在第四季度体现。因此，基于今年已采取的价格措施，我们预计第四季度平均销售价格较第三季度仍将有小幅上涨。 2. 华力微并入后，未来在运营费用、资本开支和折旧方面将产生怎样的财务影响？协同效应预计何时显现？ 答：首先，收购华力微对公司而言是一笔非常出色的交易。如各位所知，华力微月产能约 4 万片，贡献收入约 7 亿美元，毛利率约 40%。我们预计其将带来超过 2 亿美元的净利润。 并表预计可使公司整体毛利率提高约 3 至 4 个百分点。本季度公司毛利率为 24.6%，若剔除华力微贡献，为 19.9%。 3. 关于硅光，目前市场对这一细分领域的未来增长预期非常强烈，全球和国内同行也宣布了若干扩产项目。请问公司如何看待这一市场？未来在硅光市场有何规划？

	答：硅光显然是一个增长领域，与 AI 驱动的应用直接相关，今年已明显可见其有望持续增长。这也是中国市场有大量需求的领域。就您的问题，我想谈两点。 第一，我们已经身处硅光领域。光模块内部有多种不同的芯片，其中一部分我们已在生产，例如部分 MCU 产品，有些客户将其用于光模块；部分电源管理芯片和功率器件也用于其中。因此，我们并非新进入者，只是我们参与的是器件层面，而不是更集成的系统层面。 第二，我们认识到这很可能成为快速增长的领域之一，因此就硅光进行了战略讨论，研究如何最大程度地参与这一细分市场。也就是说，我们研究了光模块内所有基于硅的器件，既包括目前使用的模块，也包括 AI 带来的高算力等未来系统和未来模块。我们审视了整个细分领域，研究在器件层面需要生产哪些产品，并希望参与所有基于硅的器件。因此，我们将在已占有一定份额的基础上，进一步扩大份额，并拓展产品类型。 对于非硅基的光学产品，我们也在关注，但尚未决定进入，因为基于硅的器件已经足够多，我们希望先把这部分做好、拿到份额。 此外，在我们计划于明年很快启动的下一轮产能扩张项目中，电源管理和硅光是我们希望大幅增加产能的两个领域。我们在这一领域也增加了不少开发项目。 总之，硅光是重要领域，也是我们已经参与的领域。我们希望扩大在技术供给和产能方面的布局，希望其成为我们未来的增长因素之一。 4. 公司如何看待明年下游需求和产能利用率？展望明年，如何评估涨价的可持续性？是否预计涨价将持续？ASP 上涨预计能维持多久？ 答：价格基本上遵循市场供需，通常在供给紧张时，我们才有提价的机会。我们在这方面非常谨慎，并与客户充分沟通，因为每次涨价都需要确保客户认同，他们也需要面对自己的终端市场。因此首先需要明确：我们已采取的所有价格措施，均是与客户协商后进行的，通常基于市场状况，本质上是供需平衡问题。 在此前提下，就当前情况来看，我们仍看到一些领域需求超过我们能够提供的供给，因此我预计我们仍将选择性地小幅继续涨价，2027 年将是如此。再往后则需要非常谨慎地观察，因为市场情况会变化，但 2028 年也许是有可能的，考虑到整个半导体行业的长期增长、本轮 AI 驱动的增长浪潮，以及公司在整体市场中所处的位置，这些都使我有信

	心，我们的竞争态势将会改善。 因此，只要市场需求保持强劲，我认为我们能够选择性地、而非全面地涨价，主要集中在我们认为现在能够提供相对于需求足够供给的领域。 2026 年公司平均提价幅度约为 10%至 15%。对于 2027 年，不同产品有高有低，也有持平；同时，公司暂不希望作出更激进的判断，但预计平均售价仍将上升。到下个季度与大家交流时，我们对 2027 年或许会有更清晰的判断，可能会给出涨幅区间。 5. 随着 DRAM 向 3D 结构或 3D 堆叠转变，公司是否看到参与该价值链任何环节的机会，例如与逻辑晶圆相关的环节？ 答：存储技术演进的方向之一，是将存储单元与外围逻辑分离为不同裸片，再通过堆叠形成完整产品。NAND 已在采用这一方向，DRAM 也开始向同一方向演进。 这一趋势确实为逻辑代工厂至少提供了参与存储产品外围逻辑部分的新机会，并将带来增量逻辑代工需求。不过，也要看存储公司的选择。存储公司按定义是 IDM，可能选择外包部分逻辑裸片，也可能长期倾向自行完成全部环节，以控制整个存储产品。这一动态和决策，将最终决定我们作为逻辑代工厂能获得多少业务。 但最终，这对我们是利好：我认为我们肯定会看到业务增量，因为他们很可能决定外包部分存储产品的逻辑部分，但最终规模及放量仍需时间观察。 6. 您认为目前行业处于半导体周期的哪个位置？AI 需求非常强劲，但消费可能有些偏弱。您如何看待未来几个季度的需求趋势？ 答：AI 浪潮今年确实非常强劲，其增幅可能出乎大多数人意料，尤其是存储方面，这一轮是从存储开始的。现在这一趋势很可能也在向特色工艺、逻辑技术领域方面渗透，我们第三季度的业绩以及预期的第四季度业绩，基本上就是这一点的反映。 大多数人乐观地认为 2027 年这一趋势将持续，甚至有人预测到 2028 年。正如我此前所说，我们看不到两到三年之后，难以有非常清晰的判断，只能看它最终如何演变。 基于历史经验，我想指出一点：当出现供需失衡时，周期通常在新产能大规模上线时结束。这一次 DRAM 以及逻辑都在建设新产能，但新产能大约需要两到三年才能上线。因此，

	按照历史规律，通常在两到三年后新产能上线时，供需失衡会开始得到纠正。 但这一次也有人认为这是一轮“超级周期”，因为需求增长超过了新产能建设的速度，因此可能持续更久，这是一种乐观的观点。坦率地说，我个人并不知道答案。但基于历史经验，两到三年是一个合理的假设。再往后，就取决于需求增长速度与新产能建设速度之间的竞争。 关于需求端，AI 显然是新生事物、新应用，其本身仍在演进，其中包括市场对 AI 相关公司的预期和估值。这与半导体产品的实际需求不同，后者依然非常强劲。目前仍然相当开放的问题是，那些大模型的估值如何，终端应用最终如何落地，以及在投入如此之大的情况下如何实现盈利。 现阶段，我认为我们仍处于基础设施建设阶段。AI 就像互联网的早期阶段，会有这样一个阶段：即使终端应用仍在演进，尚不清楚最终哪种应用会最赚钱、哪种 AI 使用方式最有用，也必须首先建设基础设施。我们正处于基础设施建设阶段，芯片就是工业时代的“新石油”。因此，从公司的角度看，我有信心这一需求会持续存在，这一周期在可预见的未来应会持续。 7. 公司似乎在不同终端市场的表现总是更好，即使在消费领域，表现也好于市场增速。公司如何看待在各细分领域的定位？未来几个季度的市场策略是什么？ 答：您谈到的是半导体供应链的复杂性。我们是特色工艺代工厂，处于供应链的制造环节。通常我们汇总业绩或产出时，会按不同的技术平台分类，如 MCU、PMIC、BCD 和功率器件、逻辑与射频等。这些分类大体上直接对应我们的产能，即我们如何建设产能。 在这些技术平台上，客户制造集成电路产品。这些产品中，如 MCU，有的用于新应用、AI 相关应用，有的用于消费。再以电源管理 PMIC 为例，AI 服务器中需要，手机、电脑、普通 PC 中也需要。因此，真正的问题在于，从终端市场看，它们非常不同：消费是一个终端市场，AI 服务器是另一个终端市场。所以，对于某一个技术平台，我们总会有产品最终进入增长领域的终端市场，也有产品进入增长不太快的细分市场。 在当前情况下，由于存储产品价格较高，对消费端产生了抑制效应，尤其是手机和电脑，即传统电脑。这些是增长不快的终端市场。另一方面，所有 AI 相关的终端市场增长非常快。因此对我们而言，这是一种平均效应。以今年的 PMIC 为例，我们增长得很好，这意味着我们生产的大部分产品处

	于 AI 相关领域；消费领域增长没那么快，但平均而言我们仍在增长。 有些技术平台主要集中在一个领域，增长会更快，处于增速较高的一端。有些则更多面向终端市场的消费部分，如 CIS（图像处理器），主要在消费领域，因此我们没有看到大幅增长，但也没有看到下降，因为即使 CIS 作为产品，现在也广泛分布于整个经济和整个行业。所以，我们看到的平均效应是对我们产品的需求在增加。我不知道是否把这种复杂性解释清楚了，但这就是我们面对的情况。 此外，客户也会有意将其产品导向市场中增长更高的领域，最终转化为对我们的更高需求。也就是说，客户使用我们的技术平台制造的产品中，有更大比例进入终端市场的更高增长领域。 8. 关于需求的可持续性。您提到预计明年供需失衡状态将持续。从本季度看，消费、工业和汽车相当强劲。能否从客户角度谈谈，是什么在推动这么强的需求？目前市场似乎都聚焦于 AI，但我们的 AI 敞口看起来并没有那么大，却仍取得了相当不错的业绩。另外，展望 2027 年，有一些担忧认为当前强劲的需求只是因为库存备货。我们如何看待其可持续性？ 答：从市场需求来看，我们仍然看到 AI 相关基础设施建设将继续是我们的增长驱动力。此外，今年下半年我们也看到工业和汽车市场在改善。因此从终端市场看，AI 肯定是增长的，工业和汽车也在增长。 正如我在前一个问题中解释的，以 PMIC 为例，该平台很大一部分产品用于 AI 服务器或 AI 相关的工业产品、机器人等。因此我们认为这些市场将继续增长，我们预期至少 2027 年对我们而言将是强劲的一年。 9. 关于产能扩张。今年仍在爬坡无锡二期（FAB 9A），明年是无锡三期（FAB 9B）。但鉴于当前市场情况，需求显然强于原先预期，我们是否已看到今年及明年扩产有所加速？这将如何影响资本开支？ 答：无锡三期恰好处于开始进设备的阶段。我们已经将市场状况考虑在内，调整了设备计划，力求满足我们存在短缺的那部分市场。我们从 9 月中旬开始无锡三期新厂房的设备搬入，这是一个全新的空厂房，我们将针对我们认为市场需求最高、对我们最有利的方向进行配置。这一工作已经在进行。 而且，即便计入无锡三期的产能扩张，完成之后我们仍然看

	到短缺，因为我们目前为明年进行的产能扩张，很大一部分已被客户预订。因此，我们肯定会继续寻找增加、扩大产能的方式，并且会以有助于解决这一供需失衡的方式进行扩张。 总体上，资本开支及总量将受限于我们可用的洁净室空间。明年洁净室空间不会改变，因为无锡三期是我们要填满的厂房，我们将以尽可能快的速度填满，并配置能在财务结果或产能结果方面带来最大效益的设备。因此这部分基本已定。 除非明年过程中我们找到其他增加产能的途径，但目前没有具体进展可向大家更新。如果走到那一步，我们自然会向大家更新。 10. 关于无锡三期设备采购，因为设备供应似乎也在趋紧。国产化率是否会提高？是否可能出现无锡三期设备短缺？ 答：我们预计晶圆厂产能利用率将达到 100%，如果全年能找到一些生产效率提升，甚至会略高于 100%。包括所有将上线的新产能，我们都会充分利用，设备采购没有问题。 11. 在不同芯片平台中，哪一部分需求会持续更强？我了解您已谈到 PMIC 强劲，CIS 可能稍弱一些。那么闪存、MCU、功率半导体等其他平台的需求展望如何？ 答：仅从公司目前观察到的需求情况看，各平台需求强度从高到低依次为：MCU、闪存、PMIC、功率器件，以及 CIS。 12. 展望明年乃至更中长期，考虑价格、产品结构、折旧等不同因素，应如何预期进入明年后的毛利率趋势？毛利率未来回到 30%的可能性有多大？ 答：我们的整体毛利率在今年各季度持续改善。2026 年全年毛利率预计将高于 20%，对此我非常有信心。 至于 2027 年，随着刚才谈到的 ASP 上涨，我们预计这一势头将贯穿 2027 年，我们还将看到一定的涨幅。因此，我预计毛利率有望达到 25% 左右，甚至更高。 毛利率将随时间持续改善。今年我们的毛利率实际上提升了 7 到 8 个百分点，因为我们将产能利用率保持在极高水平、改善了产品结构，而主要原因是涨价。随着我们继续释放更多产能、提升 ASP，并且明年 Fab 9A 将满载，只要保持高利用率，这也将有助于提升毛利率。再加上明年价格继续提升，我认为毛利率改善应该会相当不错。

	13. 公司目前 AI 敞口的大致比例是多少？以及未来两三年的情况如何展望？ 答：我们确实有一套统计方法，将销售按不同终端市场分类，但旧的分类似乎已过时。鉴于新的市场状况，我们可能需要修订：旧的划分方式是计算、通信、消费，显然已不适应当前 AI 驱动的市场细分。如果纯粹区分 AI 相关与非 AI 相关，坦率地说，这一定义目前有些模糊，因为 AI 也在渗透到不同的细分领域。 公司今年显然受益于 AI 浪潮，我认为至少超过 50% 的终端产品受到 AI 发展带动贯穿所有技术平台：如我前面所解释，BCD 技术平台的很大一部分用于 AI，小部分用于消费；CIS 逻辑平台的很大一部分用于消费，但也有相当一部分与 AI 相关，因为机器人也使用 CIS 做图像处理。 因此，要获得准确的终端市场细分数据，我们还需要做一些工作。我们正在讨论调整终端市场的分类方式，以便未来能更好地回答您刚才的问题。 14. 上季度您分享了部分产品线的订单出货比（book-to-bill）约为 1.5 倍甚至 2 倍。目前是否仍维持在这样的高水平？还是看到订单出货比有所缓和的迹象？ 答：不同市场、不同产品的供需状况差异很大。有些领域我们确实达到 2:1 的比率，也有些领域供需基本平衡。平均而言，我认为至少有 50% 的订单我们无法满足。 不过，我想提醒大家谨慎使用订单出货比这一指标，因为对我们这个行业而言，这并非典型的目标指标。原因是它也与价格有关：价格低时，订单出货比是一种情况；价格高时，则会反过来。我们理想的情况是，不希望出现很高的订单出货比，而是通过提价使其更接近供需平衡点。